



证券代码：002213

证券简称：大为股份

公告编号：2021-099

深圳市大为创新科技股份有限公司 关于取得商标注册证书、发明专利证书、实用新型专利证书 及外观设计专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家知识产权局颁发的1项《商标注册证书》，公司控股子公司深圳市芯汇群微电子技术有限公司（以下简称“芯汇群”）收到国家知识产权局颁发的1项《发明专利证书》、7项《实用新型专利证书》、1项《外观设计专利证书》，具体情况如下：

一、商标注册证书

序号	注册商标名称	注册商标号	核定使用 商标类型	核定使用商品/服 务项目	注册人	注册有效 期限
1	特尔佳	第 55125418 号	国际分 类：12	汽车；汽车车身； 汽车减震器；电动 汽车；汽车底盘； 汽车车轮毂；运载 工具用制动装置； 运载工具用刹车 盘；车身；陆地车 辆用电动机(截止)	深圳市大 为创新科 技股份有 限公司	2021年10 月28日至 2031年10 月27日

以上商标的取得，不会对公司的生产经营产生重大影响，但有利于加强公司注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生，有利于提高公司品牌和市场知名度。

二、发明专利证书

- 1、发明名称：一种基于ART神经网络的晶圆缺陷检测方法
- 2、发明人：连浩臻；刘政宏；刘洪荣；闵刚；梁海波

- 3、专利号：ZL 2020 1 1462376.6
- 4、专利申请日：2020年12月9日
- 5、专利权人：深圳市芯汇群微电子有限公司
- 6、授权公告日：2021年11月30日
- 7、专利权期限：二十年（自申请日起算）

本发明公开一种基于 ART 神经网络的晶圆缺陷检测方法，该基于 ART 神经网络的晶圆缺陷检测方法，包括以下步骤：获取基于 ART 神经网络的缺陷检测模型并保存；获取扫描电镜采集的晶圆图像，并输入至所述缺陷检测模型；利用所述缺陷检测模型检测所述晶圆图像的缺陷及缺陷类型。该方法采用计算机视觉方式，通过基于 ART 神经网络的缺陷检测模型来检测晶圆缺陷，可以提高检测效率，有利于及时分析影响芯片良率的因素。

三、实用新型专利证书

（一）实用新型名称：一种可分类存储的IC分装设备

- 1、发明人：贺义；梁海波；闵刚；刘洪荣
- 2、专利号：ZL 2020 2 2637197.3
- 3、专利申请日：2020年11月16日
- 4、专利权人：深圳市芯汇群微电子有限公司
- 5、授权公告日：2021年10月8日
- 6、专利权期限：十年（自申请日起算）

（二）实用新型名称：一种具有分类抽拉存储功能的电子元器件储存箱

- 1、发明人：刘长春；张进国；李小明；刘洪荣
- 2、专利号：ZL 2020 2 2830900.2
- 3、专利申请日：2020年12月1日
- 4、专利权人：深圳市芯汇群微电子有限公司
- 5、授权公告日：2021年10月8日
- 6、专利权期限：十年（自申请日起算）

（三）实用新型名称：一种端口带独立供电模块的硬盘测试板

- 1、发明人：梁海波
- 2、专利号：ZL 2020 2 3200489.7

- 3、专利申请日：2020年12月24日
- 4、专利权人：深圳市芯汇群微电子科技有限公司
- 5、授权公告日：2021年7月20日
- 6、专利权期限：十年（自申请日起算）

（四）实用新型名称：一种供电电压可变的硬盘测试板

- 1、发明人：刘洪荣
- 2、专利号：ZL 2020 2 3172047.6
- 3、专利申请日：2020年12月24日
- 4、专利权人：深圳市芯汇群微电子科技有限公司
- 5、授权公告日：2021年10月8日
- 6、专利权期限：十年（自申请日起算）

（五）实用新型名称：一种电子元器件存储器插槽夹具

- 1、发明人：张进国；刘洪荣；闵刚；梁海波
- 2、专利号：ZL 2021 2 0404380.0
- 3、专利申请日：2021年2月24日
- 4、专利权人：深圳市芯汇群微电子科技有限公司
- 5、授权公告日：2021年10月8日
- 6、专利权期限：十年（自申请日起算）

（六）实用新型名称：一种电子元器件存储器的器件结构

- 1、发明人：张进国；闵刚；梁海波；刘洪荣；刘政宏
- 2、专利号：ZL 2021 2 0435716.X
- 3、专利申请日：2021年3月1日
- 4、专利权人：深圳市芯汇群微电子科技有限公司
- 5、授权公告日：2021年10月8日
- 6、专利权期限：十年（自申请日起算）

（七）实用新型名称：一种数据储存器的连接头

- 1、发明人：刘政宏；梁海波；刘洪荣；闵刚
- 2、专利号：ZL 2021 2 0444166.8
- 3、专利申请日：2021年3月2日
- 4、专利权人：深圳市芯汇群微电子科技有限公司

- 5、授权公告日：2021年10月8日
- 6、专利权期限：十年（自申请日起算）

四、外观设计专利证书

- 1、外观设计名称：测试板（SXmicroSTM1A-V1）
- 2、设计人：贺义
- 3、专利号：ZL 2020 3 0642287.4
- 4、专利申请日：2020年10月27日
- 5、专利权人：深圳市芯汇群微电子技术有限公司
- 6、授权公告日：2021年5月7日
- 7、专利权期限：十年（自申请日起算）

上述发明专利、实用新型专利及外观设计专利为芯汇群自主研发取得，其所涉及的技术及应用领域与公司新一代信息技术业务相关。上述专利的取得暂不会对公司近期的生产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权优势，进一步完善公司的知识产权保护体系，提升公司的竞争力。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2021年12月3日